

## セラミックコンデンサ

### Flex アセンブリ技術を用いたモジュール方式の CeraLink™

2018年11月13日

TDK 株式会社 (TSE:6762) は、Flex アセンブリ技術を用いたモジュール方式の CeraLink FA タイプの投入により、実績のある CeraLink™ コンデンサのラインアップを拡張しました。この省スペース設計により、同じ端子上に 2 個、3 個または 10 個の同一のコンデンサを並列に接続して、容量を増加させることが可能です。

新しい CeraLink FA タイプは、定格電圧 500 V DC、700 V DC、および 900 V DC が用意されています。定格容量は、電圧およびコンデンサの数によって 0.5  $\mu$ F ~ 10  $\mu$ F です。これら PLZT (ジルコン酸チタン酸鉛ランタン) セラミックコンデンサの 1 つの特徴は、150 °C の高い許容動作温度です。FA タイプは、幅 7.4 mm、高さ 9.1 mm であり、長さ 6.3 mm、9.3 mm、または 30.3 mm です。小型サイズにも関わらず、リップル電流耐量は最大 47 A<sub>RMS</sub> です。

並列スイッチングの大きな利点の 1 つは、0.1 ~ 1 MHz の高い周波数で 10 m $\Omega$  を大幅に下回る非常に低い ESR 値であることです。ESL の値も、最低 3 nH と非常に低いです。CeraLink コンデンサは、低い寄生効果により、GaN や SiC など高速スイッチング半導体をベースとするコンバータ・トポロジーに理想的です。スイッチング時の電圧オーバーシュートは、従来のコンデンサ技術よりはるかに低くなっています。また、CeraLink コンデンサでは、サイズ、電流耐量、および耐熱温度に関わる特殊な要件にも簡単に対応できます。

-----

#### 主なアプリケーション

- 高速スイッチング・コンバータにおける DC リンクまたはスナバコンデンサ

#### 主な機能および利点

- 定格電圧： 500 V DC ~ 900 V DC
- 容量： 0.5  $\mu$ F ~ 10  $\mu$ F
- 低い寄生効果
- GaN や SiC など高速スイッチング半導体をベースとするコンバータ・トポロジーに適切

-----

### TDK 株式会社について

TDK 株式会社（本社：東京）は、各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で 1935 年に設立されました。

主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMS センサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambda があります。

アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、現在、情報通信機器、コンシューマー製品、自動車、産業電子機器の分野において、電子部品のリーディングカンパニーを目指しビジネスを展開しています。2018 年 3 月期の売上は約 1 兆 2000 億円で、従業員総数は全世界で約 103,000 人です。

-----

本文および関連する画像は [jp.tdk-electronics.tdk.com/181113-1](http://jp.tdk-electronics.tdk.com/181113-1) からダウンロードできます。

製品の詳細情報は [jp.tdk-electronics.tdk.com/ceralink](http://jp.tdk-electronics.tdk.com/ceralink) で参照できます。

お問合せは [marketing.communications@tdk-electronics.tdk.com](mailto:marketing.communications@tdk-electronics.tdk.com) までお送りください。

-----

### 報道関係者の問い合わせ先

担当者	所属	電話番号	Email Address
大須賀	TDK 株式会社 広報グループ	+81 3 6852-7102	pr@jp.tdk.com